株式会社ブイ・テクノロジー

2027 年 3 月期　第 2 四半期(中間期)決算説明会

2026 年 11 月 13 日

イベント概要

[企業名]	株式会社ブイ・テクノロジー
[企業 ID]	7717
[イベント言語]	JPN
[イベント種類]	決算説明会
[イベント名]	2027 年 3 月期　第 2 四半期(中間期)決算説明会
[決算期]	2026 年度　第 2 四半期
[日程]	2026 年 11 月 13 日
[ページ数]	30
[時間]	13:00 – 13:57 （合計：57 分、登壇：25 分、質疑応答：32 分）
[開催場所]	インターネット配信
[会場面積]	
[出席人数]	
[登壇者]	3 名

代表取締役 社長執行役員	杉本　重人（以下、杉本）
取締役 専務執行役員	神澤　幸宏（以下、神澤）
IR 室室長	小野　雅弘（以下、小野）

[アナリスト名]*	ジェフリーズ証券	中名生　正弘
	みずほ証券	斉田　健一
	フィリップ・キャピタル証券	和泉　美治

*質疑応答の中で発言をしたアナリスト、または質問が代読されたアナリストの中で、SCRIPTS Asia が特定出来たものに限る

登壇

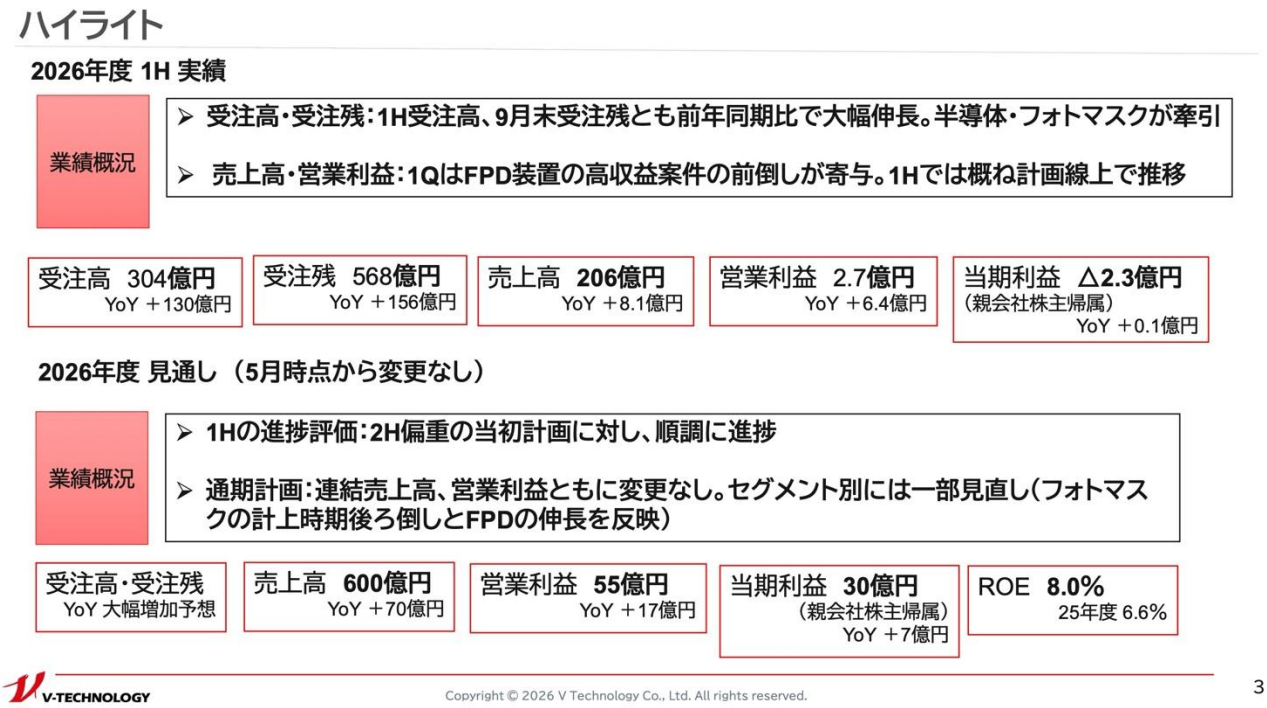
小野：本日は、ご参加いただきありがとうございます。これより、株式会社ブイ・テクノロジー2027 年 3 月期中間決算説明会を開催いたします。本日司会を務めます、IR 室長の小野と申します。

はじめに、本日の出席者を紹介します。代表取締役社長執行役員の杉本、取締役専務執行役員の神澤です。

本日の進行について簡単にご案内します。まず、決算について専務の神澤よりご報告します。その後、社長の杉本より成長戦略についてご説明します。その後、皆様からの質疑応答の時間を設けています。終了は 14 時を予定しています。

神澤専務、よろしくお願いします。

神澤：神澤です。平素は大変お世話になっております。私から、2026 年度第 2 四半期決算についてご説明します。続いて、成長戦略に関しては杉本社長からお話しします。



まず、上期実績と年間見通しのハイライトです。上期の受注高は、前年同期比 130 億円増の 304 億円、受注残は 156 億円増の 568 億円となりました。半導体・フォトマスクが拡大しました。

売上高は、8 億 1,000 万円増加の 206 億円、営業利益は 6 億 4,000 万円増加の 2 億 7,000 万円となりました。半導体・フォトマスクの売上高は、上期としては過去最高となりましたが、利益の本格貢献は期初から変わらず下期以降を想定しています。上期は、FPD 装置の高採算案件が貢献しました。

上期の営業利益が黒字にもかかわらず、最終利益で前年同期並みの赤字となった要因としては、大きく三つ挙げられます。

一つは持分法による投資損失、二つ目は為替差損、三つ目は連結対象子会社の中で上期の税引前利益がマイナス、かつ繰延税金資産を計上する税効果会計をとれない会社が複数存在するため、結果として税金費用が膨らむ形になったことです。

続いて、2026 年度の見通しです。5 月時点から変わらず、売上高 600 億円、営業利益 55 億円を見込んでいます。ROE 目標 8%も据え置いています。

後ほどご説明しますが、売上高のサブセグメント構成は、上期の進捗を踏まえ若干変更しています。

2026年度 1H 連結業績

- ✓ 半導体・フォトマスク、FPD装置ともに前年同期比増収
- ✓ FPD装置の高採算案件により営業利益は黒字転換
- ✓ アドバンストパッケージのDI露光装置量産機の売上計上は2H集中の見込み

単位：百万円	2025年度 1H	2026年度 1H	増減
売上高	19,744	20,557	+813
営業利益	△370	266	+636
利益率	*△1.9%*	*1.3%*	
経常利益	△406	22	+428
利益率	*△2.1%*	*0.1%*	
親会社株主に帰属する中間純利益	△239	△234	+5
利益率	*△1.2%*	*△1.1%*	
EPS(円)	△25.33	△24.77	+0.56

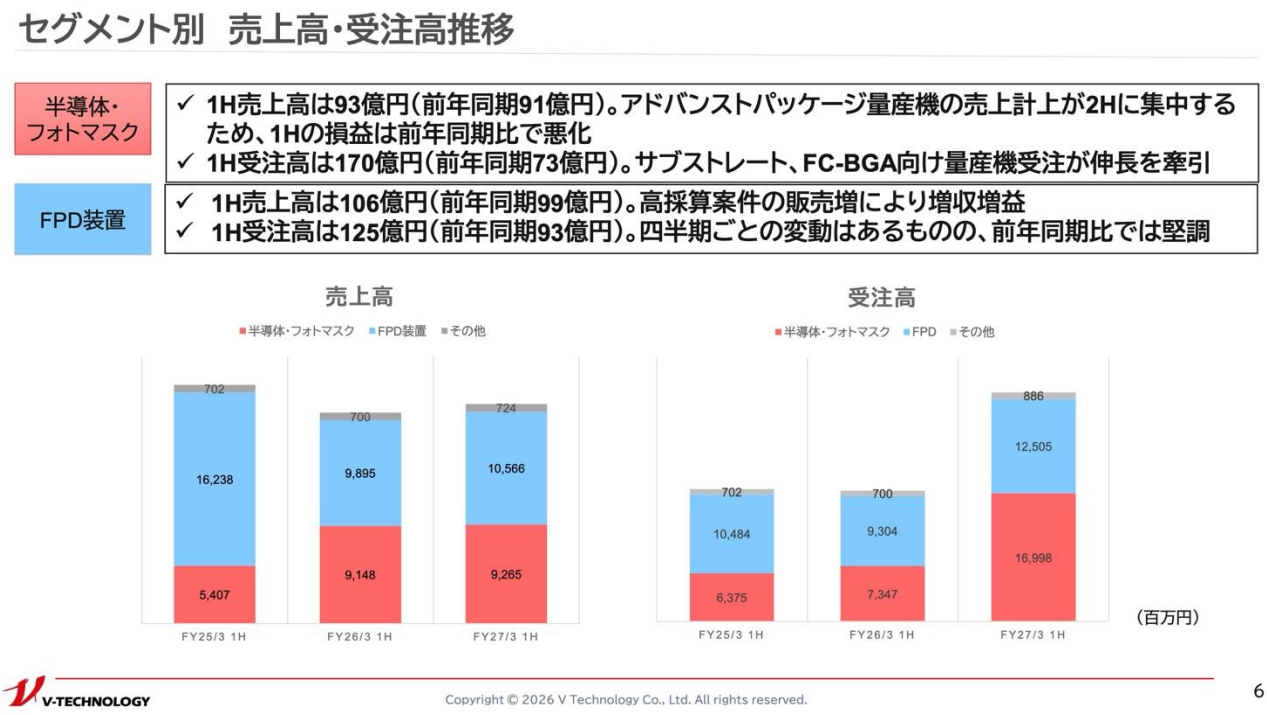
V-TECHNOLOGY

Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

5

上期の連結業績です。このページの数字はハイライトで述べたので、コメントを 3 点確認したいと思います。

半導体・フォトマスク、FPD 装置ともに前年同期比増収、FPD 装置の高採算案件により営業利益は黒字転換、アドバンストパッケージの DI 露光装置量産機の売上計上は下期集中の見込み、以上です。



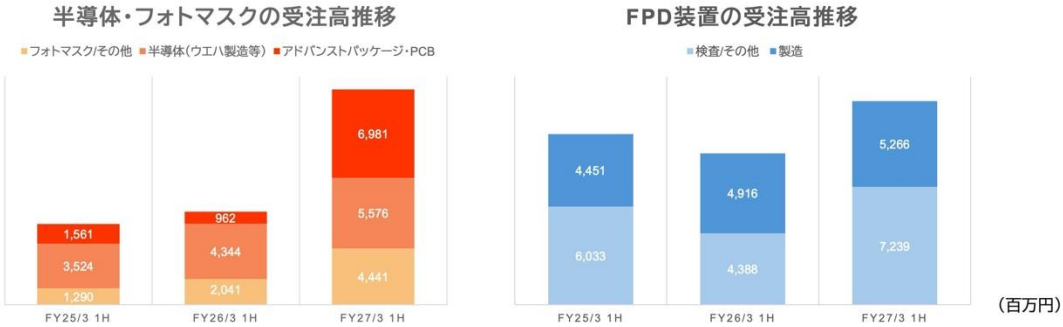
過去 3 年間のセグメント別上期売上高と受注高の推移です。半導体・フォトマスク、FPD 装置ともに増収となりましたが、25 年第 4 四半期のアドバンストパッケージの大型受注が計上されるのが下期の特に第 4 四半期が中心となるため、半導体・フォトマスクの上期は若干の増収にとどまりました。

FPD 装置は、24 年度の大型案件、これは青い棒グラフの一番左です。この終了後、25 年度に減少しましたが、その水準からは安定的に推移しました。

一方、半導体・フォトマスクの上期受注高は、赤い棒グラフの一番右ですが、170 億円と前年同期比 2 倍以上に拡大しました。AI 半導体向けアドバンストパッケージが大きく貢献しました。FPD 装置の受注も順調でした。

半導体・フォトマスクとFPDのサブセグメント受注高推移

半導体・フォトマスク	✓ アドバンストパッケージ：70億円（前年同期10億円）に拡大 ✓ パッケージサブストレート既存向け追加受注、新規顧客からの量産機受注が寄与
FPD装置	✓ 1H受注高：125億円（前年同期93億円）。検査・その他が増加

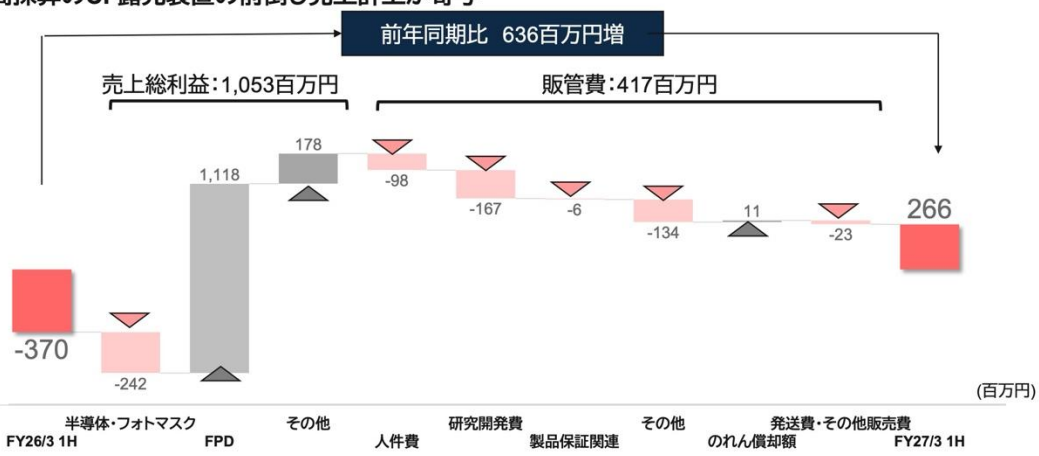


V-TECHNOLOGY
Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

過去 3 年の受注高をサブセグメントごとに見たいと思います。半導体・フォトマスクの受注高では、アドバンストパッケージ・PCB の拡大が顕著ですが、フォトマスクも大きく増加しました。右側の FPD 装置では、検査装置の受注増加が目立ちました。

営業利益増減要因（1H 前年同期比）

- ✓ 半導体・フォトマスク：営業損失542百万円（前年同期 営業利益46百万円）、売上総利益率24%、販管費比率29%。アドバンストパッケージを中心に、当初より収益貢献は2H偏重を想定
- ✓ FPD装置：営業利益792百万円（前年同期 営業損失309百万円）、売上総利益率31%、販管費比率23%。高採算のCF露光装置の前倒し売上計上が寄与



V-TECHNOLOGY
Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

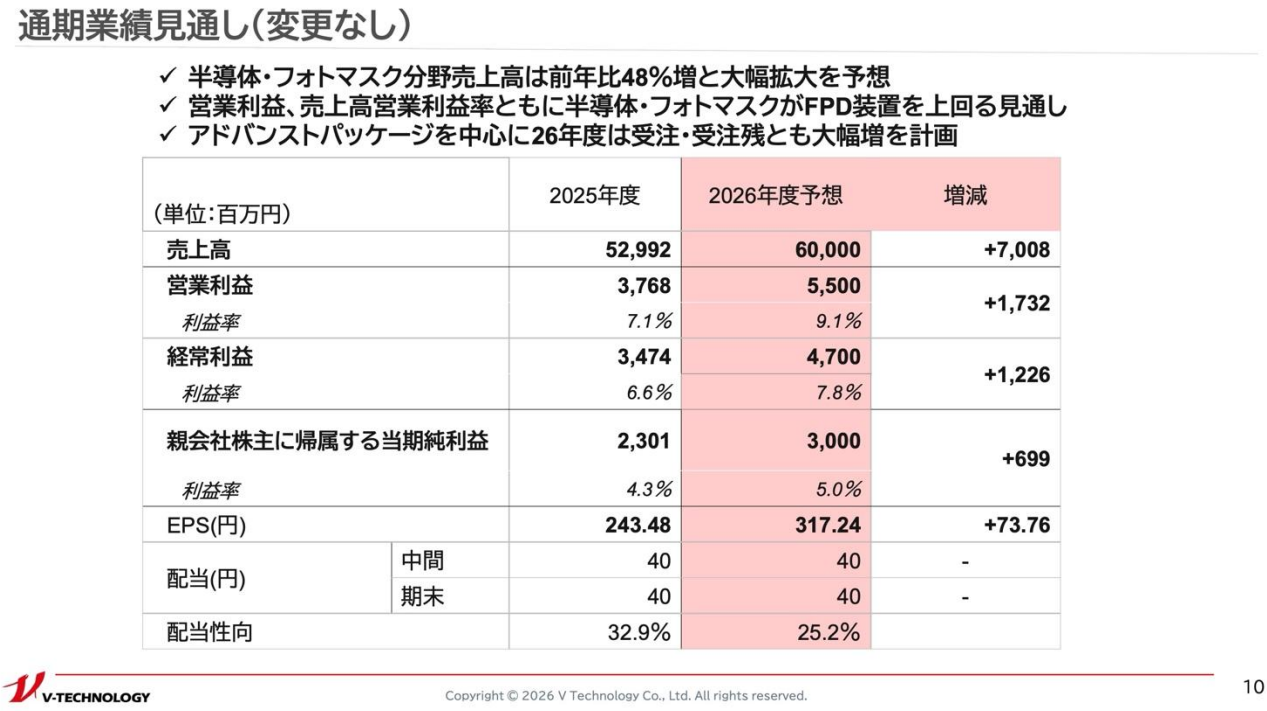
営業利益の増減要因についてご説明します。上期の営業利益は、全体ではプラス 2 億 6,600 万円でしたが、半導体・フォトマスクだけで見ると、約 5 億円の赤字となりました。

SCRIPTS
Asia's Meetings, Globally

半導体・フォトマスクの売上高は前期比微増ながら、営業利益で赤字となった原因は、半導体ウエハ製造ラボ等、アドバンストパッケージ・PCB の各サブセグメントにおける大幅減収による粗利益の減少、低粗利益率の装置案件による粗利益の減少、そして販管費の増加です。これはおおむね当初から計画されていたものです。

一方、FPD 装置は、特に第 1 四半期に高採算な CF 露光機の前倒し売上計上があったことなどが寄与し、売上総利益で大幅な増加となりました。

販管費は、前年同期比で 4 億円増加していますが、先ほど述べた半導体・フォトマスクの研究開発費の増加が主な要因です。

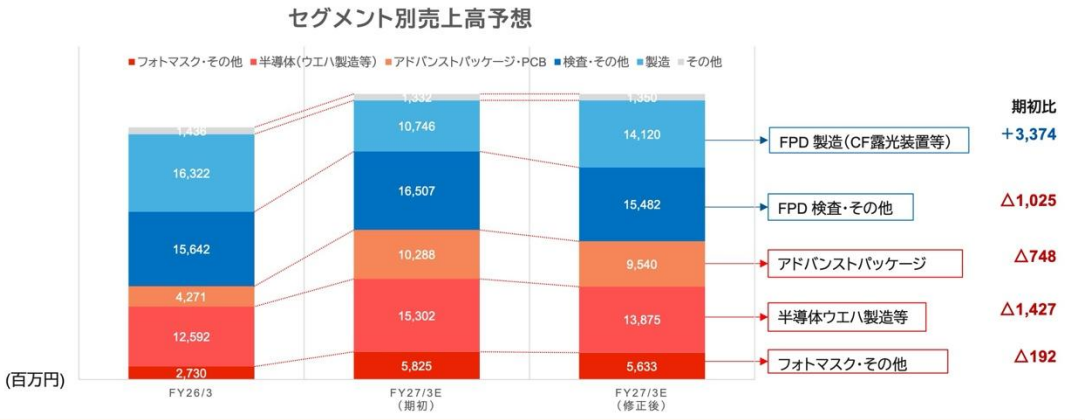


2026 年度通期の業績見通しについてお話しします。売上高 600 億円、営業利益 55 億円を据え置いています。

上期業績は計画に対して順調に進捗しており、期初に販管費に織り込んだ中東情勢等の地政学的リスクなどは、今のところ想定以下の費用増にとどまっていると考えています。

セグメント別売上高予想（期初計画と修正後の比較）

✓半導体ウエハ製造、フォトマスク検査装置を需要要因から下方修正
✓アドバンストパッケージ・PCBは設置時期の一部延伸も受注拡大で27年度かけて成長確度高まる
✓CF露光装置の25年度からの延伸分の寄与が想定以上



V-TECHNOLOGY
Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

セグメント別の 26 年度売上高予想を示しました。全体の 600 億円は変わりませんが、セグメント間の構成を一部変更しました。

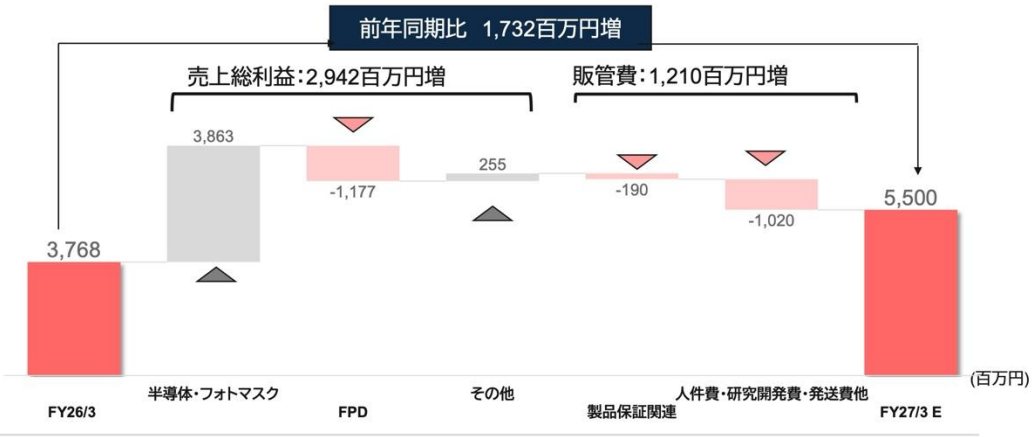
半導体・フォトマスク分野における各サブセグメントの売上計画を引き下げました。半導体ウエハ製造等、およびフォトマスク、その他のサブセグメントについては、上期までの受注、顧客の設置スケジュールを踏まえ、当初計画達成は難しいと判断しました。

しかし、アドバンストパッケージ・PCB サブセグメントについては、上期までの受注実績、第 3 四半期に入ってからの引き合いや受注の状況から、27 年度の売上成長目線はむしろ高まっています。

FPD 装置については、CF 露光装置を中心とした製造サブセグメントの売上計画を引き上げ、検査装置を引き下げました。

営業利益見通し(通期)

✓ 半導体・フォトマスクセグメントでの大幅増収・増益を予想
✓ 製品保証関連費用は減少を見込む一方、足元の地政学情勢を踏まえた輸送コスト上昇などを保守的に織り込み、販管費は増加



V-TECHNOLOGY
Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

これを受け、通期営業利益の見通しについても、FPD セグメントの営業利益計画を上方修正し、半導体・フォトマスクセグメントを下方修正しました。

収益性の高いフォトマスクの減少、CF 露光装置の増加というミックスを考慮し、全社営業利益予想は変更しませんでした。

CF 露光の受注は、当面は減少傾向が想定されるため、来期 27 年度の FPD 装置の売上高、営業利益にはマイナス要因といえます。

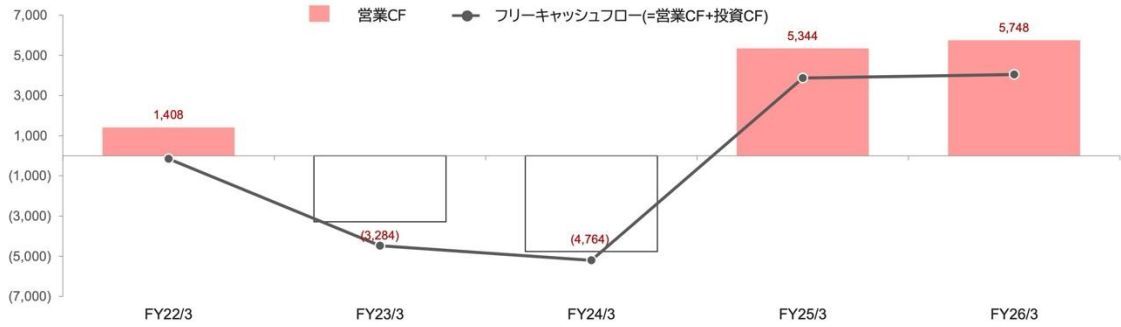
一方で、アドバンストパッケージにおける DI 露光装置の量産機の大型受注が売上計上されることで、半導体・フォトマスクセグメントの収益は大きく増加すると考えています。

27 年度は、中期計画のゴールの 28 年度の達成確度が問われる重要な年になると考えています。われわれは、アドバンストパッケージ・PCB セグメントの牽引により、売上、営業利益の成長に対する自信を従来以上に深めています。

SCRIPTS
Asia's Meetings, Globally

営業キャッシュフローの改善に注力

✓アドバンストパッケージ向け装置の設置が26年度2Hに大幅増となる中、前期並みの営業キャッシュフローを目指す
✓装置リードタイム短縮を含めた仕掛品回転月数の短期化等を推進し一層の改善に注力する



(百万円)

V-TECHNOLOGY
Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

キャッシュフローについてお話しします。継続的な成長実現のためには、営業キャッシュフローは極めて重要な業績評価手法であると考えています。

弊社は、装置の受注から設置までのリードタイム、仕掛かり品在庫の回転期間が長いこと、売掛債権の回収期間が長いことも課題と受け止め、その改善努力を続けてまいりました。

25 年度は一定の成果を出したものの、26 年度はアドバンストパッケージにおける DI 露光機の量産機設置など、一定のキャッシュアウトが必要となるため、従来実現できていなかった前受金の取得に対する明確な目標を掲げ、前年度並みの営業キャッシュフロー実現を目指します。

ここについて少し補足します。現在、DI 露光装置の受注活動が活況を呈していますが、これを営業キャッシュフローの改善の千載一遇のチャンスと捉え、契約時に極力多くの前受金を受け取ることを目指し営業活動をしてもらっています。

SCRIPTS
Asia's Meetings, Globally

株主還元

業績計画達成に全社的に取り組むと同時に業績結果に応じた株主還元を目指す

- ✓事業拡大に向けたM&Aや設備投資など経営基盤強化に必要な内部留保を勘案しつつ、配当の安定性・継続性・配当性向等を総合的に考慮
- ✓経営成績に応じた利益還元を行う方針
- ✓年間配当は前年と同額の80円を計画するが、今期業績の進捗等を踏まえ、積極的な利益還元も検討
- ✓株主還元の充実に向け、機動的な自己株式取得等について引き続き検討

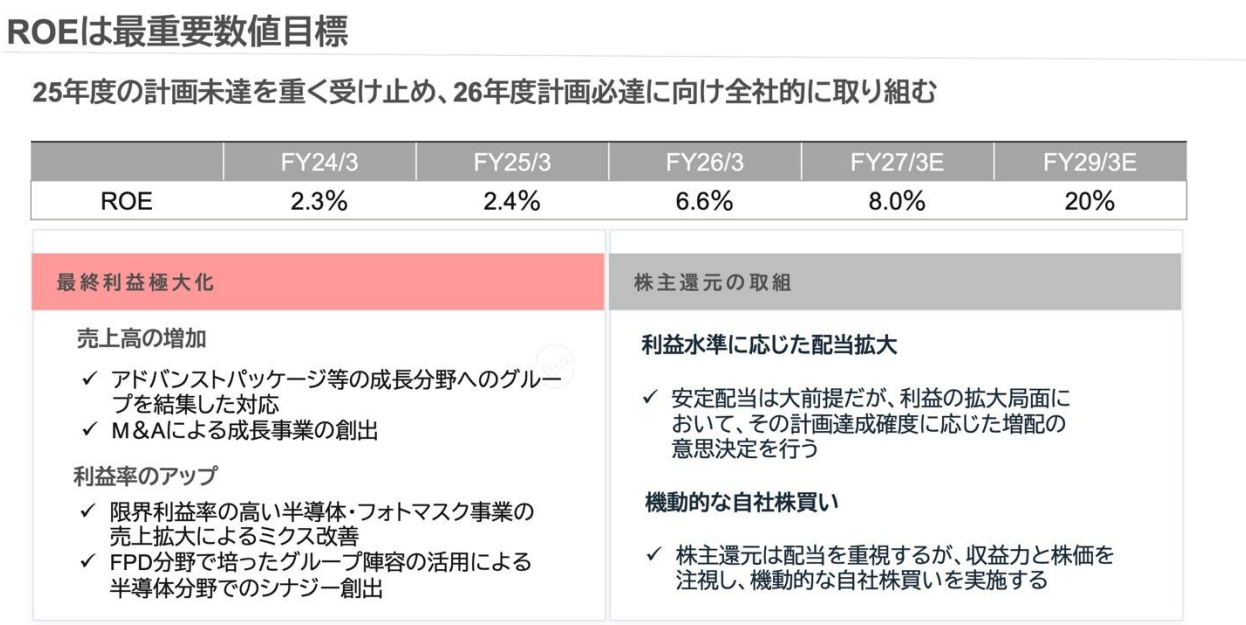
項目		FY22/3	FY23/3	FY24/3	FY25/3	FY26/3	FY27/3(予想)
配当金額(総額/百万円)		1,176	882	586	765	765	765
配当性向(%)		*30.6*	*334.7*	*74.2*	*95.2*	*32.9*	*25.2*
一株当たり配当金(円)	中間	60	60	30	40	40	40
	期末	60	30	30	40	40	40
	総額	120	90	60	80	80	80

V-TECHNOLOGY
Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

株主還元についてです。期初に申し上げたとおり、26 年度の年間配当計画は 80 円と据え置いていますが、配当性向 30%を意識しており、大きな投資案件がなく当初の業績計画を達成した場合には、積極的な株主還元を実行したいと考えています。

自社株買いも機動的に考慮するスタンスは従来と変わっていません。一方で、10 月 7 日に新 TOPIX の移行措置銘柄に指定されたことで、投資家、ステークホルダーの皆様にはご心配をおかけしています。

今後は、継続基準達成に向け、業績成長はもちろんのこと、浮動株比率を上昇させるために自己株買いを控える選択も考慮したいとは思っています。



最後に、最重要指標である ROE については、中期計画最終年度に ROE20%超を達成する目標は変えていません。26 年度計画の 8%から 2 年間で大きく上昇する目標になっています。

達成のためには、高成長高収益が目指せるアドバンストパッケージを軸とした売上拡大と合わせ、グループ内での効率化と徹底したコスト管理、不採算事業からの撤退も視野に入れ、実行してまいります。

私からは以上となります。ありがとうございました。

小野：続いて、成長戦略について社長の杉本よりご説明します。杉本社長、よろしくお願いします。

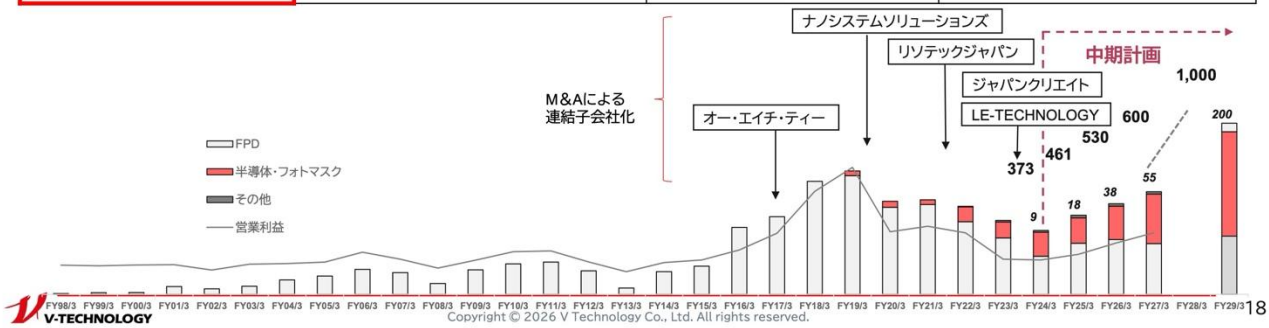
杉本：杉本でございます。皆様の前で半年ぶりにお話しできる機会をいただいたので、できるだけたくさんの情報をお話ししたいと思います。

また、この半年でわれわれを取り巻く環境は大幅に変化しており、その変化の中で営業活動、開発、生産活動、コストダウン、さまざまな活動に励んでいますが、その辺の一端もお話しできたらと思います。

成長戦略：FPDから半導体へ、成長ドライバを転換

半導体に係る日本が強い分野へ参入・・・装置事業は顧客との共同開発が不可欠

参入市場	業界を代表する企業名	当社グループ	主要製品
シリコンウェハ	信越化学工業、SUMCO、他	ナノシステムソリューションズ ジャパンクリエイト	シリコンウェハ検査、洗浄
フォトマスク	テクセンドフォトマスク、DNP、HOYA、他	ブイ・テクノロジー	検査装置（Vテクオリジナル製品）
レジスト材料	東京応化工業、JSR、信越化学工業、 住友化学、富士フイルム、他	リソテックジャパン	研究室用レジスト評価装置
アドバンストパッケージ	イビデン、新光電気工業、 TOPPANホールディングス、他	LE-TECHNOLOGY オー・エイチ・ティー	DI露光装置、オープンショートテスタ、 マイクロプローブ



Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

2018 年以降、当社は FPD 一本足打法から半導体へと展開を進めてまいりました。いくつかの小規模な M&A により、27 年 3 月期にようやく FPD と半導体の売上比率がほぼ同じになります。

われわれはまた、2025 年 3 月期に中期経営計画を策定しましたが、その成長牽引役は間違いなく半導体・フォトマスクの拡大といえます。

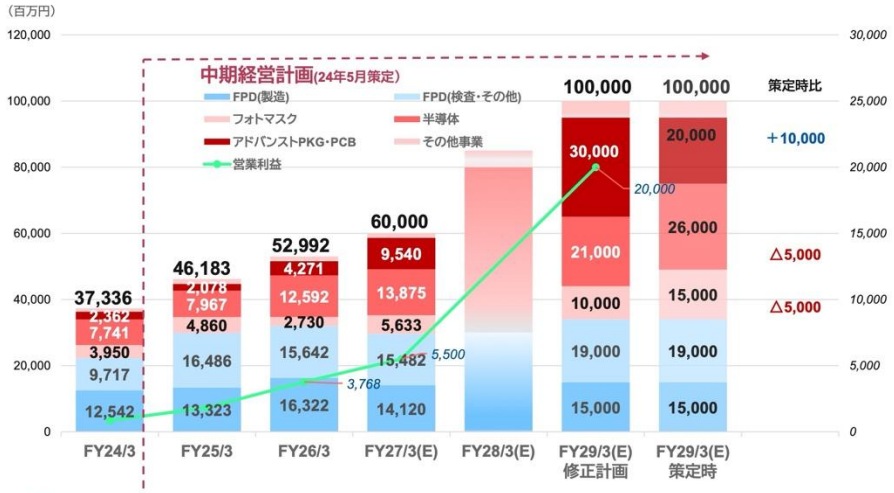
中でも AI 半導体向けの先端パッケージが、中期計画の計画達成の重要なドライバーになることは前回申し上げたとおりです。その需要の強さは想定以上に強いものと感じています。

そういった背景で、今回は中期経営計画におけるアドバンストパッケージ・PCB セグメントの 2029 年 3 月期の売上目標を 200 億円から 300 億円に引き上げることにしました。

一方で、フォトマスクについては、FPD 向けを中心に中国メーカーの内製化が想定されていることから、見通しを若干引き下げ、ウエハ検査装置においても成長持続が予想されるものの、従来に比べ若干慎重に見ています。

成長戦略：中期経営計画達成に向けて

2029年3月期に売上高1,000億円、営業利益200億円の目標を維持
受注環境から、アドバンストパッケージ分野の進捗は策定時の想定を上回るペース



セグメント		狙う市場	主力製品
半導体フォトマスク	アドバンストパッケージ・PCB	・半導体パッケージ基板 ・汎用PCB基板	DI露光、O/Sテスター
	半導体	・シリコンウェハ ・フォトレジスト、他	・検査 ・マスクレス露光 ・コーデベ、他
	フォトマスク	・レガシー半導体 ・FPD	検査、修正、測定、他
FPD	検査・その他	LCD、OLED、他	検査、修正、測定、他
	製造	LCD、他	ｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰ露光 光配向露光、他

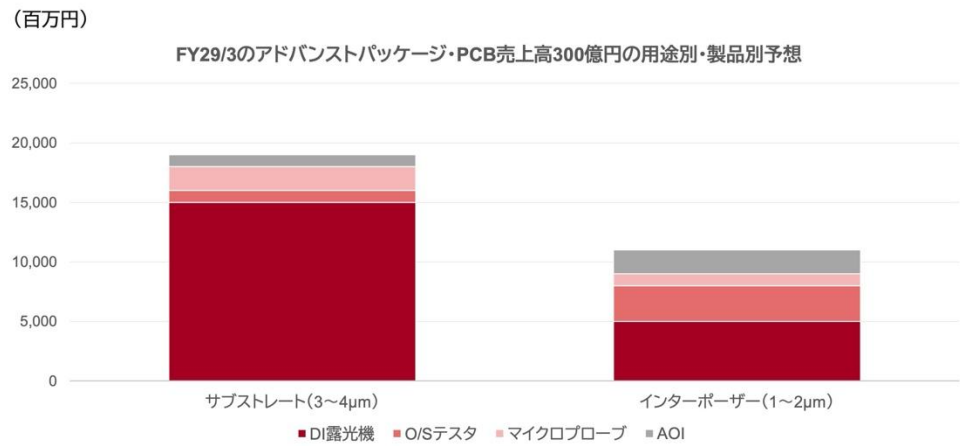
Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

従いまして、2029 年 3 月期に売上高 1,000 億円、営業利益 200 億円の全社目標は据え置きます。引き続き、達成に向けてまい進していく所存です。

成長戦略：中期経営計画最終年度のアドバンストパッケージの売上構成

✓アドバンストパッケージ・PCBのFY29/3売上高300億円計画は、サブストレート向けDI露光装置が主な成長ドライバ

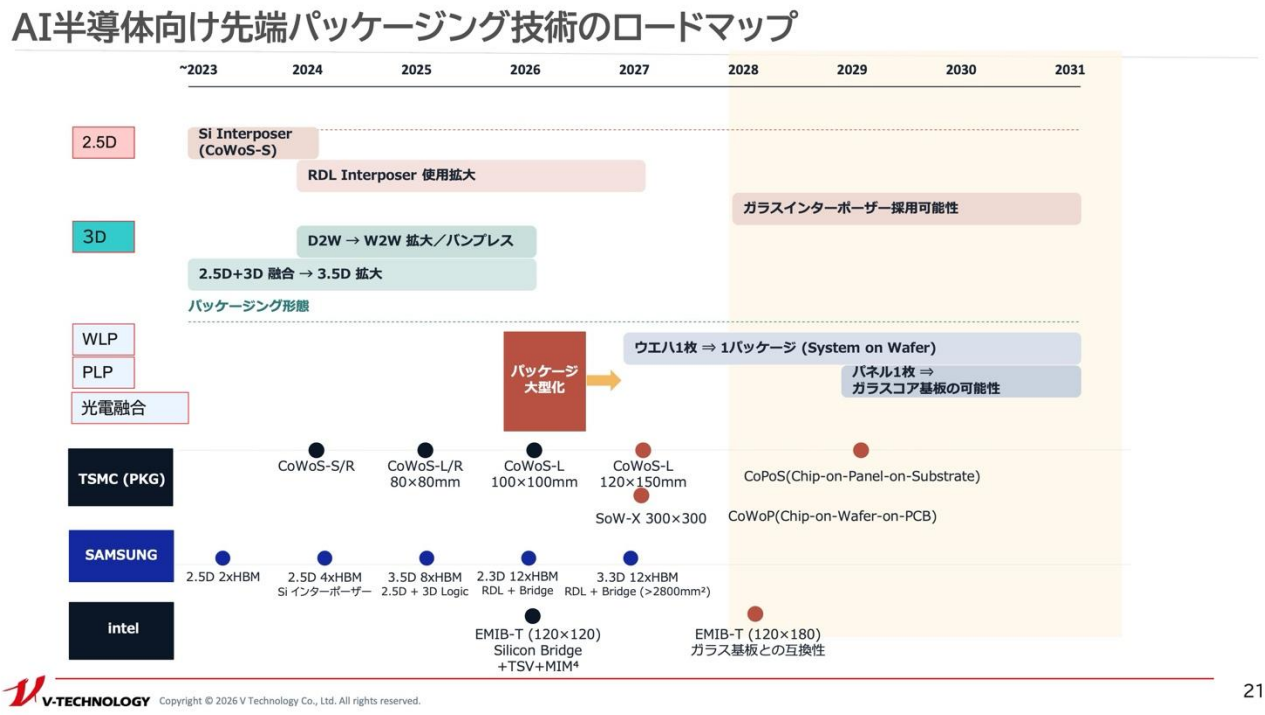
✓インターポーザ向けも、O/Sテスターを含め売上成長フェーズに移行



Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

今回、2029 年 3 月期のアドバンスパッケージの売上高目標を 200 億円から 300 億円に上方修正しましたが、その中身について少し説明します。

現時点では、2029 年 3 月期のサブストレート向けとインターポーザ向けの比率は 2 対 1 ぐらいと見ていますが、装置別の売上構成では、DI 露光装置が 200 億、テスタ、マイクロプローブ、そして AOI を合わせて 100 億円程度になると考えています。



V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

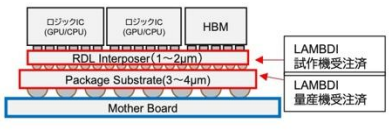
先端パッケージング技術のロードマップを前回もお示ししましたが、これはそれほど大きく変化していません。

成長戦略：アドバンストパッケージ事業の強化

- ✓ AI用半導体パッケージの分野に集中
- ✓ DI露光装置、O/Sテスタ、マイクロプローブを有することでクロスセルが可能

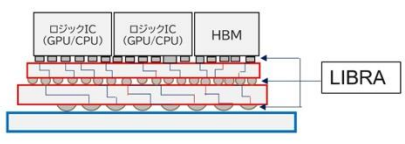
DI露光装置「 LAMBDI 」

- 大手パッケージ基板メーカーから量産機を受注。26年度中に設置予定。
- インターポーザ向けでは、試作機の受注が本格化へ

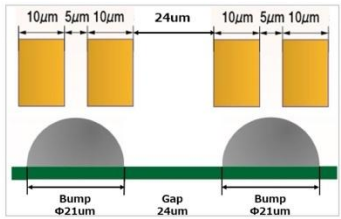


テスター「 LIBRA 」

- パッケージ基板・インターポーザ(RDL)上の端子間の電気的な検査を、世界で初めて実現
- 25μm ピッチ端子の4端子検査に業界で初めて対応



マイクロプローブ



V-TECHNOLOGY Copyright © 2026 V Technology Co., Ltd. All rights reserved.

パッケージメーカーの設備投資がかなり加速していることと、GPU を搭載するパッケージサブストレートやインターポーザにとどまらず、CPU を搭載する FC-BGA の生産増強も加速しています。

それに伴い、私どもの連結子会社である LE-TECHNOLOGY の DI 露光装置 LAMBDI に対する引き合いが大変強いものとなっています。

既に国内のパッケージメーカー様から頂戴した 3 ミクロンの量産機の追加に加え、海外メーカーから 3 ミクロンに加え 4 ミクロン解像度の量産機に対する商談も頂戴しています。

3 ミクロンから 4 ミクロンのサブストレートや、FC-BGA 向けの DI 露光装置の受注は、今期 2027 年 3 月期から 2028 年 3 月期にかけてさらに拡大していく見通しです。

パッケージサブストレート向けの露光装置技術は、一部ステッパーの採用が残りますが、DI 露光装置がおそらく圧倒的なシェアになっていくものと私たちは考えています。

パッケージサブストレート向けの露光装置メーカーは他に 2 社ほどありますが、私どもはこの 3 ミクロン、4 ミクロンで高解像度というところにウエートを置き、大変強い競争力を持って活動しているので、高解像度を得意とするわれわれのシェアはさらに拡大していくものと考えています。

また、インターポーザについて、1 から 2 ミクロンというさらに高解像度になるわけですが、ここはどの方式、どのインターポーザが主流になっていくのかがまだ決定していません。

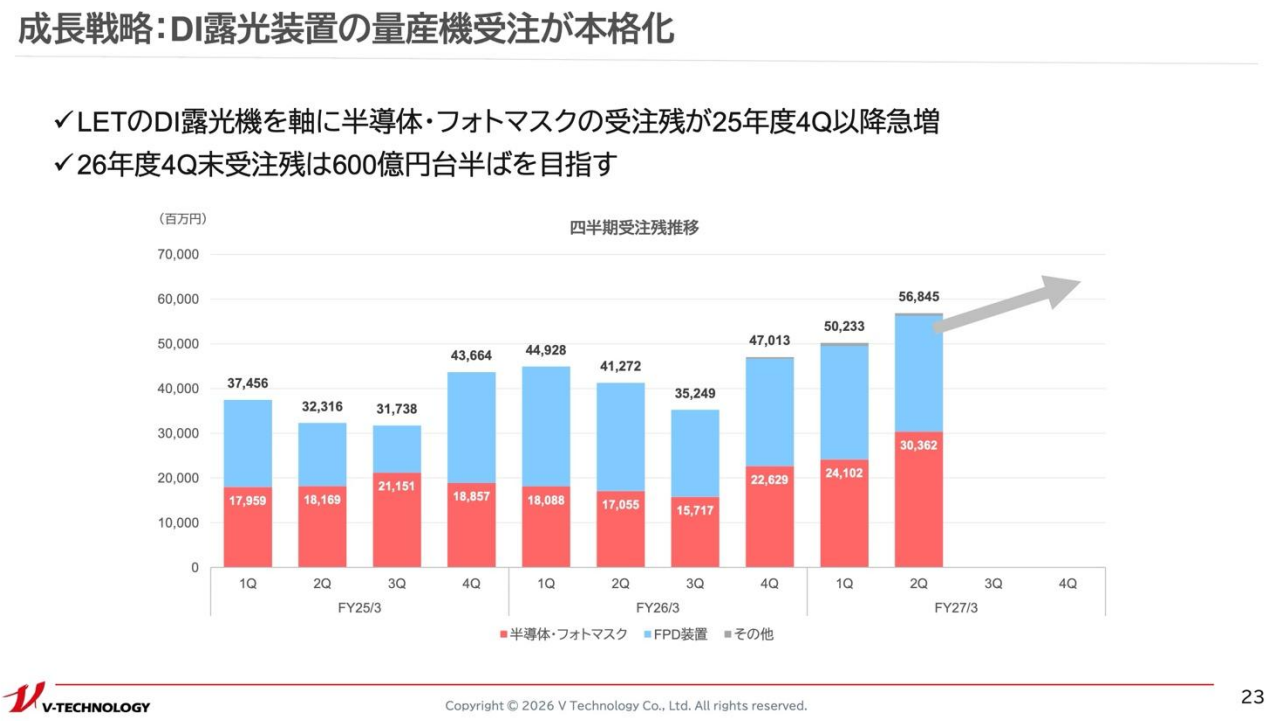
それぞれの会社様がそれぞれの考えに基づき、ガラスコアになるのか、ガラス基板に有機配線をつくっていくのか、もしくはシリコンウエハの拡大版でやるのか、そういったところがまだ未確定ではありますが、現在は各社、各様、その装置構成に基づいた評価をやっている真っ最中です。

量産はおそらく 2030 年ぐらいから、どの方式になるかはそれぞれだと思いますが、ここが急拡大のマーケットになっていくと、それまではこの FC-BGA を含め、サブストレートのマーケットが私どもの DI 露光事業を推進していくと考えています。

いずれにしても、サブストレートとインターポーザの両睨みで、今の製品に加えさらなるスピードアップやコストダウン、いろいろな技術を駆使し、お客様の要求する装置をわれわれはつくっていこうと考えています。

次に、われわれの強みとして、サブストレートの導通検査の事業を展開しており、DI でパターンをつくり、つくったパターンが導通、きちんとつながっているか、つながっていないか、それをテストするための事業も現在推し進めています。

既に受注は今期から始まっていますが、量産が始まると、この装置は確実に必要な機械になるので、こちらのマーケットもいずれは大変大きなわれわれのビジネスになると考えています。



先ほど専務の神澤から説明した、受注残の推移についてご覧いただきたいです。2026 年 3 月期の第 4 四半期から急速に受注が伸びていることがこの表からわかると思います。

これは、まさにアドバンストパッケージ・PCB セグメントにおける DI 露光装置の量産機の発注が始まったからです。まだインターポーザは始まっていません。

ということで、この量産機の受注があと数年間は続くと思います。加えて、2 年後ぐらいからインターポーザの量産機の受注が入るということで、この DI 露光のビジネスはものすごく大きく成長すると大変期待している事業です。

また、昨日受注が確定した案件について適時開示したのですが、少しコメントしておきます。国内に続き、海外のパッケージメーカーさんから、LAMBDI の 3 ミクロン、4 ミクロンの量産装置を約 70 億円受注しました。

これで 2026 年 3 月期第 4 四半期からの累計で約 160 億円という規模の受注まで進んだということです。

受注残の明確な計画値は公表していませんが、2027 年 3 月期末には 600 億円台半ばを目指し、受注獲得に注力しています。

受注が今後どんどん増えていく中で、やらなければならないことがたくさんあります。まずは、生産の拡大です。現在、年間 25 台程度のラインを持っているのですが、2 年以内にこれを年間 100 台、約 4 倍のキャパまで増やすということで、協力会社様と相談しながら考えている最中です。

引き続き、株主・ステークホルダーの皆様の期待にお応えすべく、事業にまい進していく所存でございます。

ありがとうございました。